

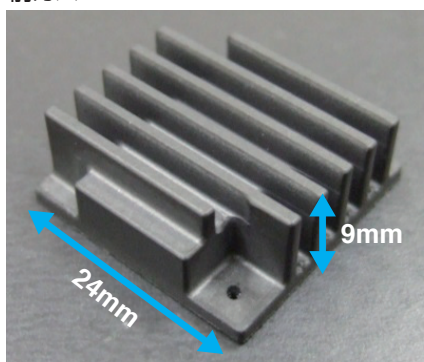
高熱伝導/高強度/シールド樹脂 開発品 UNX7007による部材コスト低減のご提案

特徴・利点

- 高熱伝導率
- 高強度
- 電磁波シールド特性

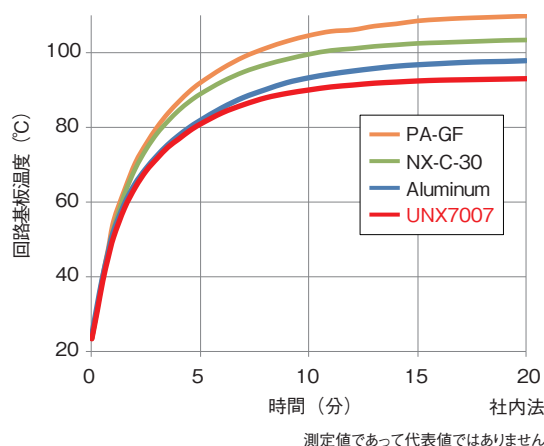
放熱テスト

前カバー

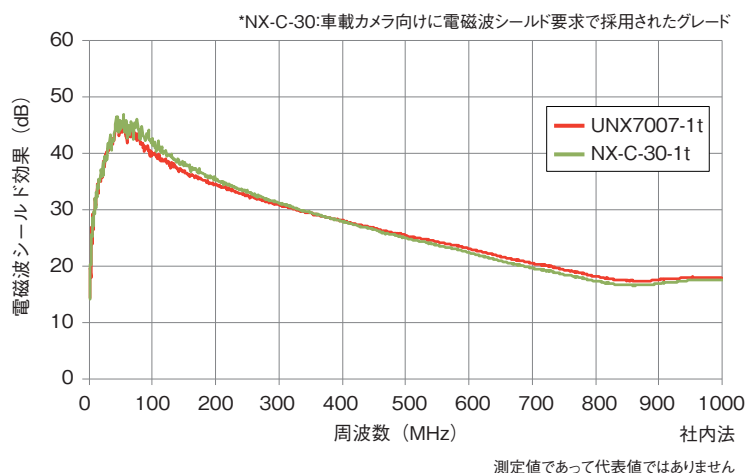


- 各種材料で前カバーを作成
- 後カバーはガラスポリアミドを使用
- 回路付近の温度を測定
- 消費電力は1.4W

各種材料での温度測定結果



電磁波シールド特性 (NX-C-30と同等のシールド特性)



対象部品

- 放熱用ケース

未来への提案

- 部品コスト削減
- アルミダイキャスト → 二次加工コスト低減
- 従来の放熱樹脂 → 部品数削減
- 従来の放熱樹脂 → 高速ICへの対応